



2021 第一季 法人說明會

泰碩電子股份有限公司

(股票代號：3338)

風險事項提醒

- 本簡報由 [泰碩電子股份有限公司 \(本公司\)](#) 提供，本簡報所含資料僅以當時之情況為準，本公司不會就本文公開後所發生任何變動更新或修正內容。
- 本簡報資料含有前瞻性敘述。這些前瞻性敘述將受風險、不確定性、假設或其它因素影響，有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
- 受邀與會之賣方 (sell-side) 研究員、券商自營部門人士，及投資先進等，在本業績發表會上，**請不要以手機(或任何形式) 發送訊息**；另外，在各投資先進之內部報告上，**請不要書寫本公司之客戶名稱**，感謝幫忙。

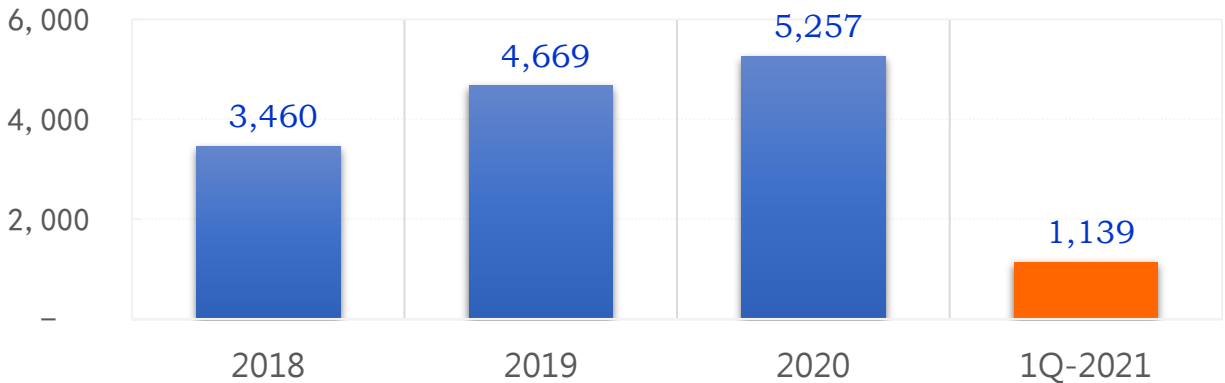
議 程

- 2021年第一季度營運成果 梁竣興 總經理
- 市場經營及發展策略 劉克平 熱傳事業處
資深副總經理
- 散熱技術及未來展望 劉克平 熱傳事業處
資深副總經理
- 提問與討論

2021 年第一季營運成果

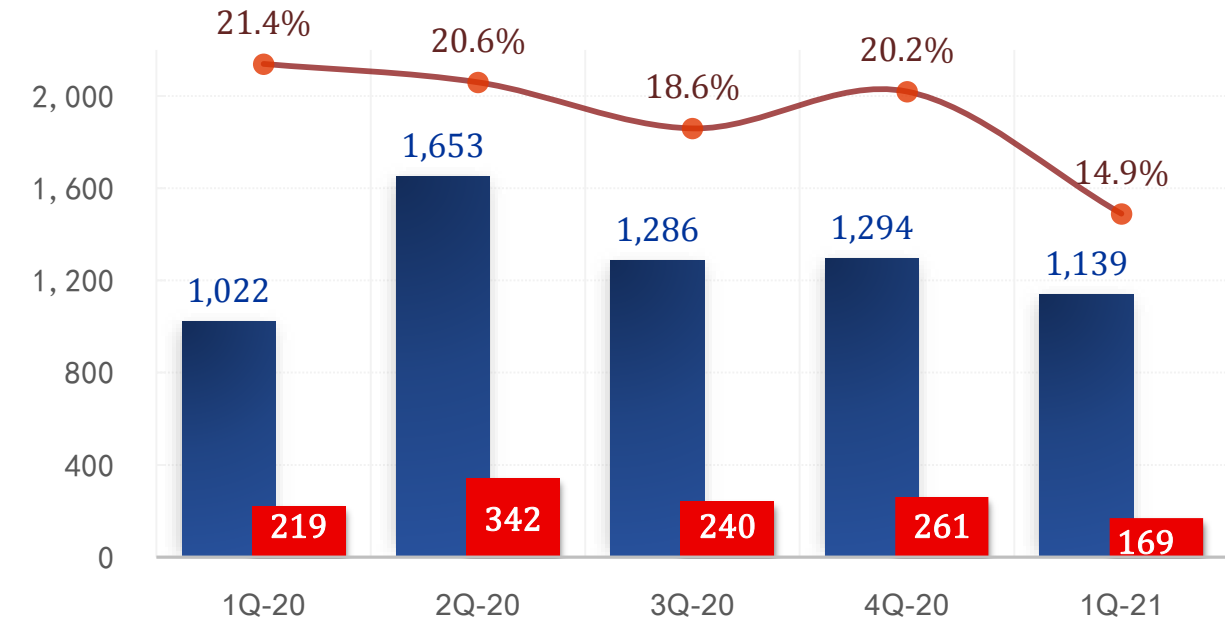
合併營收及毛利

新台幣百萬元



最近3年

營收 (YoY)	2018	2019	2020
	+13%	+35%	+13%



1Q, 2021

	YoY	QoQ
營收	+11%	-12%
毛利	-22%	-35%

2021年第一季 合併綜合損益表

新台幣 千元	2021年第1季		2020年第4季		季成長	2020年第1季		年成長
營收淨額	1,139,482	100.0%	1,294,184	100.0%	-12%	1,022,144	100.0%	11%
營收毛利	169,995	15.0%	261,409	20.0%	-35%	219,163	21.0%	-22%
營業費用	149,949	13.0%	185,078	14.0%		155,879	15.0%	
營業淨利	20,046	2.0%	76,331	6.0%	-74%	63,284	6.0%	-68%
業外收支	(960)	0.0%	(15,323)	-1.0%		23,520	2.0%	
稅前淨利	19,086	2.0%	61,008	5.0%	-69%	86,804	8.0%	-78%
所得稅費用	7,784	1.0%	21,478	2.0%		23,707	2.0%	
本期淨利	11,302	1.0%	39,530	3.0%		63,097	6.0%	
母公司業主	11,302	1.0%	39,530	3.0%	-71%	63,097	6.0%	-82%
基本每股盈餘 (新台幣元)	0.13		0.45			0.73		

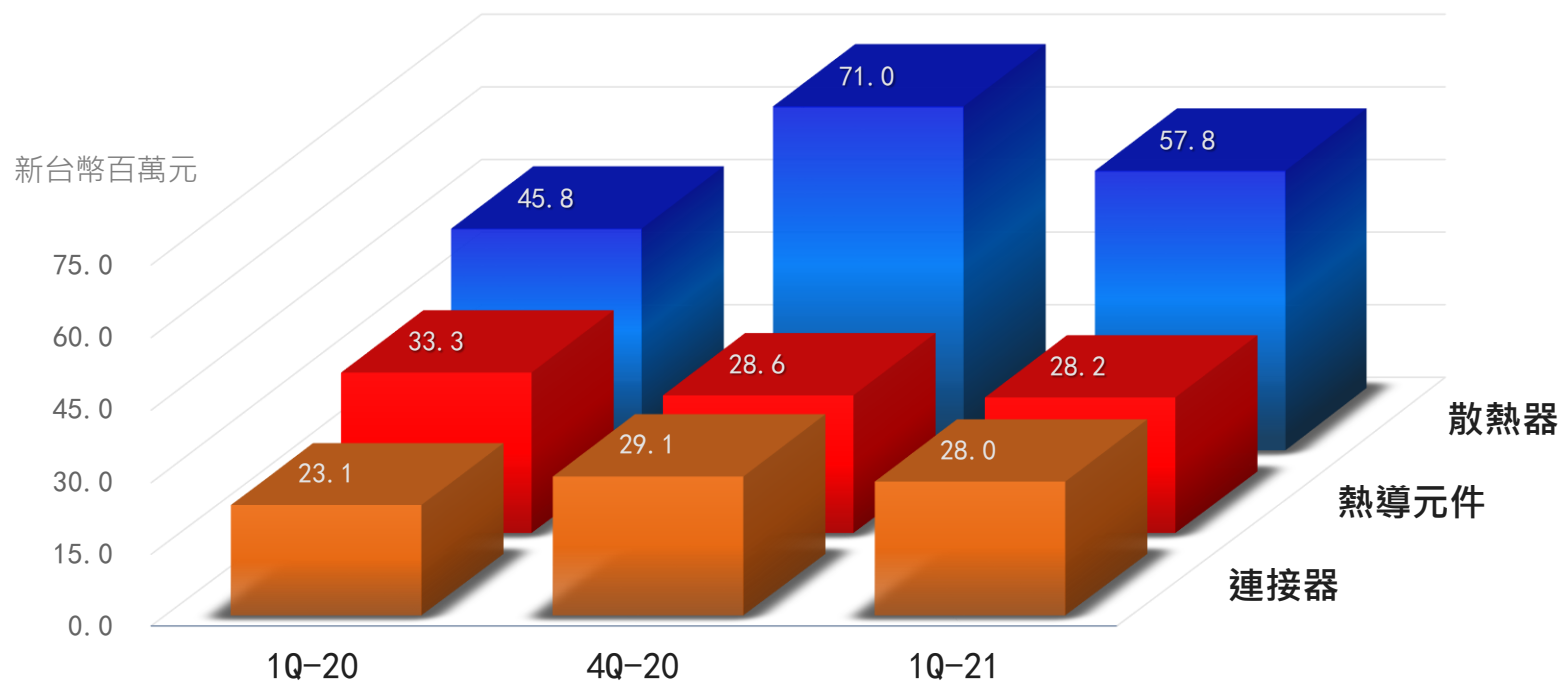
註：財務資料係採IFRS編製基礎

2021年第一季 合併資產負債表

新台幣 千元	2021年第1季		2020年第4季		2020年第1季	
現金及約當現金	595,898	15%	667,015	15%	631,488	16%
應收票據及帳款	1,821,437	45%	2,083,944	47%	1,878,410	47%
存貨	647,546	16%	637,898	15%	452,599	11%
流動資產	3,222,568	80%	3,560,517	81%	3,168,006	79%
資產總計	4,017,114	100%	4,388,662	100%	4,027,431	100%
應付票據及帳款	1,156,343	29%	1,249,851	28%	952,566	24%
流動負債	1,932,846	48%	2,304,953	53%	1,947,385	48%
負債總計	2,329,017	58%	2,701,495	62%	2,387,374	59%
股東權益總計	1,688,097	42%	1,687,167	38%	1,640,057	41%
每股淨值-母公司(新台幣元)	\$19.2		\$19.2		\$18.8	
應收帳款周轉天	157		147		179	
存貨周轉天	61		48		52	
應付帳款周轉天	113		105		121	
現金週轉天期	104		89		110	

註：財務資料係採IFRS編製基礎

營收 依產品佔比

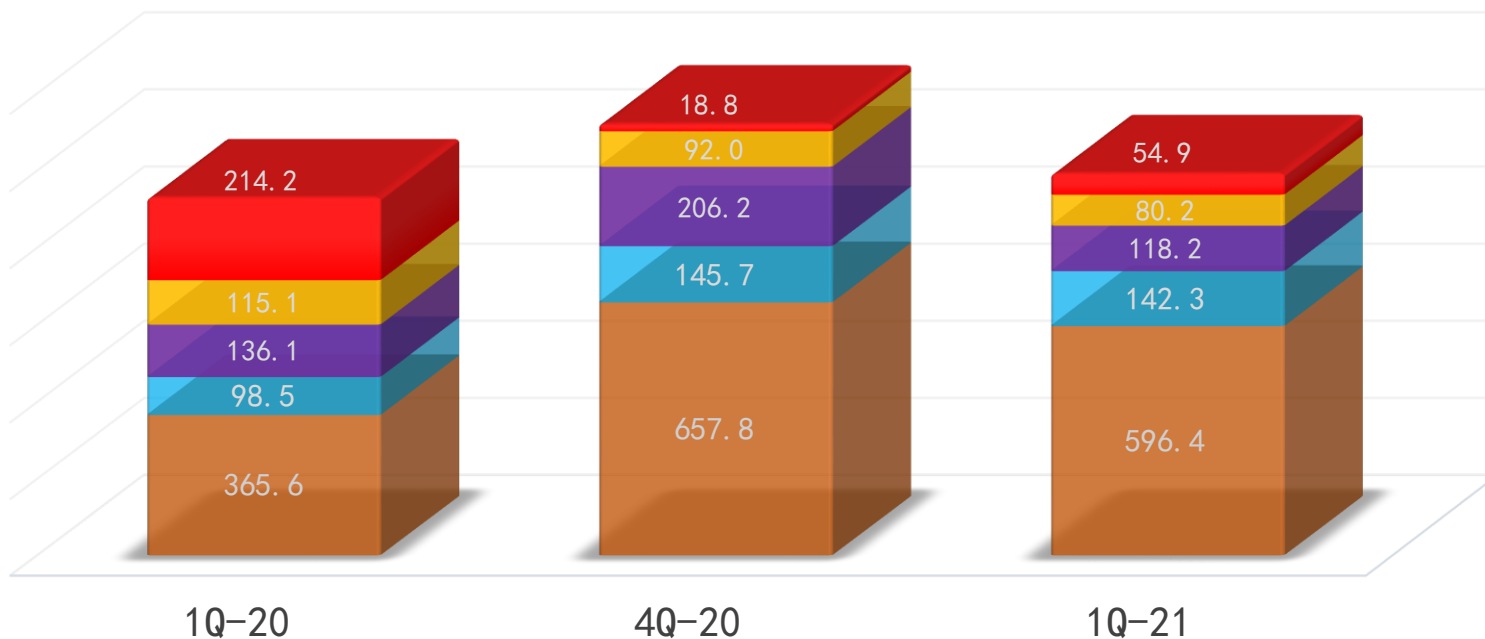


產品	1Q-20	4Q-20	1Q-21	季成長	年成長	1Q-21 & 4Q-20 摘要
連接器	22%	23%	24%	-2.1%	28.5%	筆電需求維持高檔 新增多款Chromebook擴大下半年訂單
熱導元件	32%	22%	25%	1.89%	-10.3%	5G手機市場不如預期 高階,商用,超薄NB 即時補位，總營收持平
散熱器	45%	55%	51%	-16.6%	33.8%	遠端辦公及宅經濟持續推動NB及伺服器需求

營收 依應用佔比

新台幣百萬元

1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0



應用	1Q-20	4Q-20	1Q-21	1Q-21 & 4Q-20 摘要
 NB	36%	51%	52%	1Q-21拉貨強勁，2021年需求可望持續穩健攀升 Chromebook & 高階商務機 是 新一波成長動能
 伺服器	10%	11%	13%	雲端服務及資料中心帶動伺服器出貨逐季成長
 台式&一體機	13%	16%	10%	受疫情影響，筆電取代桌機效應
 通訊	11%	7%	7%	目前市場尚未全面需求64 & 32通道AAU產品， 市場需要更多5G終端與5G場景以構建AAU需求。
 智慧手機	21%	2%	4%	5G智慧手機朝高端化發展， 但熱管及均熱板價格競爭，採選擇性接單。

市場經營及發展策略

通訊基地台 發展策略



目前現行市場尚未全面需求 64/32 通道AAU

- 5G需求待更多終端產品及運用的建構
- AAU更新設計
- 市場競爭，ASP下調，產品回歸至散熱器 (BBU、光通訊、承載網以及核心網)，AAU需求面再確認。

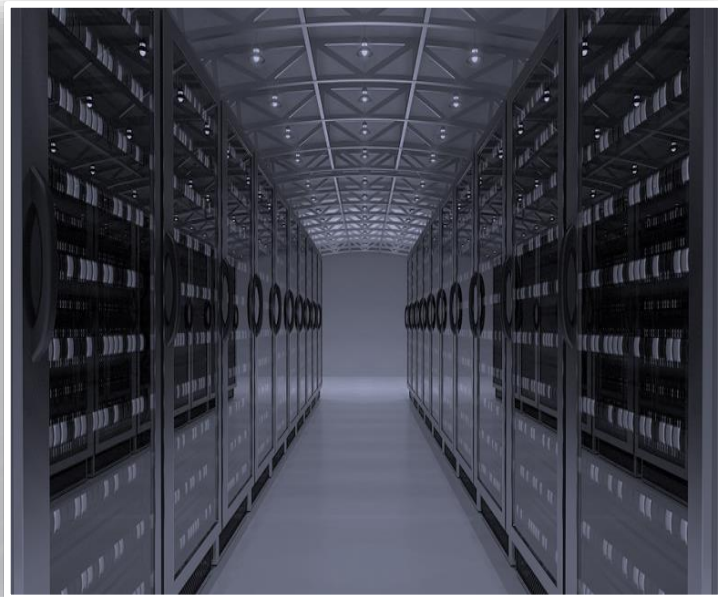
個人電腦 發展策略



遠距工作,數位學習,新應用趨勢推動PC成長

- 高階 & 低階 筆電機種需求皆成長：數位學習使低階 Chromebook量大有利滙注營收，同時在高階商用NB需求持續，預期有效提高ASP以平衡毛利，後續將持續直接配合國際品牌開發電競及商務筆電機種，並以各式散熱元件及連接器產品組合增加訂單。
- 與國際CPU大廠合作高階NB機種之VC散熱方案，開始進入預研開發階段以提前布局新應用。
- DT & AIO 維持業績：固然在疫情催化下，NB取代桌機及一體機正逐步發酵，已經成功增加客戶可望保持穩定出貨動能。
- PC/NB需求延續，訂單上看至3Q，整體市場出貨暢旺，惟IC 及電子元件缺料為變數。

伺服器 發展策略



雲端及線上經濟擴大,伺服器維持動能

- Intel & AMD 平台：1H Intel Purley 出貨量仍維持；2H 新平台Whitley逐步上量, 可提升ASP及銷售額, 下一世代 Eagle Stream 設計陸續定案, 進入小批量試產。AMD 平台方面, 在 Purley & Whitley 換平台期間 訂單量明顯增加, 因多元產品組合, 於新舊平台轉換不受影響, 穩定提高業績。
- 直接與 雲端服務商 合作取得AVL, 並以合作開發案直接取得供應機會, 以指定泰碩供應商模式與取得 ODM 廠主要採購主力。

電動車/車載系統 發展策略



電動車 三電(電機、電控、電池) 構成整車核心部件，供應鏈訂單從無到有，隨產業規模強勁成長

- 中控電腦系統散熱：供應電動車大廠比亞迪多款汽車，開發TEC熱電制冷晶片散熱，控制器散熱箱體、高導熱壓鑄件、水冷等。
- 汽車電子控制單元散熱：開發新技術域控制器(DCU/MDC) 水冷散熱，以及驗證各式水冷板成型及焊接工藝之最佳組合，以滿足產品規格及量產可能性。
- 先進駕駛輔助系統(ADAS)之專用CPU散熱模組
- 中控電機系統及電池包散熱：與多家新能源汽車公司建立聯繫並研擬高熱導元件散熱方案。
- 高功率LED頭燈熱管散熱器。
- 耕耘多年車用電子系統，累積豐富經驗與能量，研發新技術及新工藝，加盟MIH爭取與一線車廠合作業務。

智慧手機/消費性電子 發展策略



週期性換機及新興地區新增需求，手機可望復甦，而疫情與國際局勢不確定，晶圓代工產能緊缺，產業仍存變數

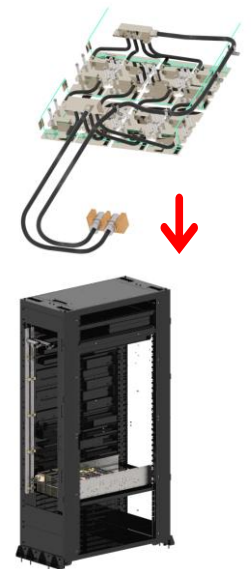
- 5G智慧手機：持續與各大品牌廠開發主力機種。然而近期材料成本高漲及紅色供應鏈競爭，ASP競爭激烈，採選擇性接單，持續關注手機市場變化、審慎跟案備料、穩定生產及提高良率。
- 高階商用/電競 NB VC 技術開發：品牌大廠商務NB系列機種，VC於 3Q上量；電競 NB VC 6月上量, ASP 提高。
- 高功率雷射(激光)投影機：近年雷射光源技術發展迅速，應用在投影機上具高亮度、高解析度、壽命長、免維護等優勢，在高階投影應用上不久後必將取代燈泡投影。與日本品牌客戶及國內專業ODM廠開發3D熱管/VC氣冷，及水冷散熱方案可有效降低雷射光源功耗及機殼內部高溫，以技術領先取得市場先機。

散熱技術及未來展望



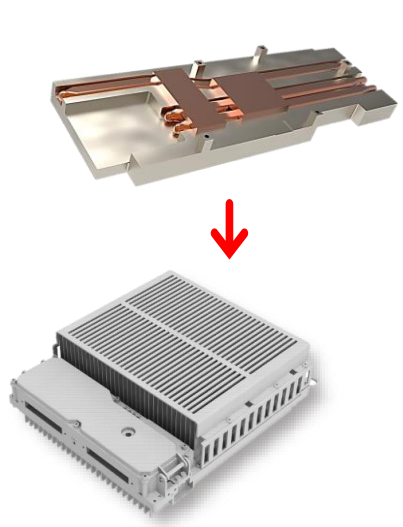
高階氣冷散熱

高功率伺服器
資料中心/雲端應用
VGA顯示卡
網路交換器



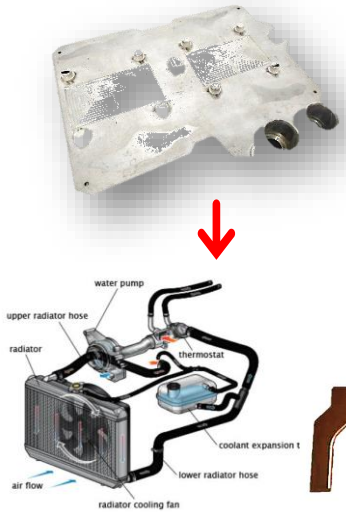
液(水)冷散熱

新世代伺服器
機櫃式伺服器
電射投影機



5G應用

5G基站
5G網通設備
小基站/CPE



車用散熱(電動車)

中控電腦
中控電機及電池包
汽車電子控制單元
車載娛樂系統



熱導元件

高階商務NB
智慧手機/電競手機
高階投影機

高功率CPU氣冷
高功率GPU氣冷
Switch氣冷散熱

水冷板
開放式/封閉式水冷
浸沒式水冷系統
Manifold多節點水冷

熱虹吸散熱器
吹脹板散熱箱體
高導熱大型壓鑄件
特殊型VC散熱器

TEC熱電制冷晶片
車載水冷模組
域控制器水冷散熱
車用CPU散熱模組

0.25~0.3mm薄VC
1.0~4.0mm厚VC
不銹鋼VC

-Thank you -



Q & A

www.taisol.com

sales@taisol.com